

第 20 回半導体・センサ パッケージング技術展

第 20 回 半導体・センサ パッケージング技術展

ISP 2019
アイエスビー

2019 年 1 月 16 日から 18 日まで東京ビッグサイトで開催される「第 20 回半導体・センサ パッケージング技術展」に出展します。

話題の mini LED や小 pin IC 対応のダイボンダー「BESTEM-D321plus+」を日本初出展いたします。

ダイボンダーの分野においてあらゆるニーズにお応えできるラインナップをご用意しております。

また、生産能力を向上した三次元形状計測装置「BESTEM-V110」もパネル出展し、お客様の開発や生産を支えるソリューション提案に繋げる技術や商品のご紹介をさせていただきます。

是非とも当社ブースにお立ち寄りくださいますよう、お願い申し上げます。

開催期間	2019 年 1 月 16 日（水）～18 日（金） 10：00～18：00（最終日のみ 17：00 まで）	
会場	東京ビッグサイト 東ホール	
当社ブース	No.E25-4	
交通アクセス	http://www.bigsight.jp/general/access/index.html	
出展機種	Mini LED,小 pin IC 対応ダイボンダー BESTEM-D321plus+ 	三次元形状計測装置（パネル・動画） BESTEM-V110 
本展示会・製品に関するお問い合わせ： キヤノンマシナリー株式会社 セミコンシステム事業本部 営業部 電話番号：077-566-1822 FAX番号：077-566-1833 E-Mail：sales-ml@canon-machinery.co.jp		